

杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于签署〈战略合作框架协议〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-041。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、同意《关于签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-042。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、同意《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-043。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日